

Huawei disposera d'un processeur ARM Cortex-A15 à 8 cœurs

Richard Yu, le PDG du *Consumer Business Group* d'Huawei, a annoncé qu'un SoC intégrant un processeur ARM à 8 cœurs sera présent dans des terminaux mobiles de la compagnie dès le second semestre 2013. Le **K3V3** fera suite au K3V2 qui équipe des terminaux mobiles estampillés Huawei. Il devrait être fabriqué par le fondeur TSMC.

Après le smartphone 6,1 pouces, le CPU 8 cœurs

L'annonce reste toutefois laconique puisqu'un « processeur ARM Cortex-A15 à 8 cœurs » a été indiqué sans précisions sur le nombre de cœurs qui disposeront de cette architecture.

Samsung, de son côté, a d'ores et déjà levé le voile sur [sa nouvelle arme](#) censée atomiser la concurrence. Avec 8 cœurs segmentés en quatre unités à microarchitecture Cortex-A15 et quatre autres Cortex-A7 selon la technologie big.LITTLE d'ARM, la future puce (disponible au second semestre 2013) s'arroe la puissance, mais ne déroge pas à la frugalité énergétique.

Interrogation sur le nombre de cœurs Cortex-A15

Le prochain SoC conçu par Hisilicon de concert avec Huawei qui équipera les successeurs des Ascend D2 et Ascend Mate, pourrait donc disposer d'un même agencement de cœurs (on peut aussi imaginer des variantes : 6+2 par exemple).

Toutefois, au-delà des spéculations, il reste une certitude : le SoC K3V2, qui embarque un processeur quadricœur à architecture Cortex-A9, met en œuvre un dispositif implémenté directement dans le silicium nommé AIPS (pour *Artificial Intelligence Power Scaling*). Littéralement, il permet de gérer le nombre de cœurs des CPU et GPU en fonctionnement.

Dès lors, avec un tel système implémenté dans le K3V3, 8 cœurs Cortex-A15 n'apparaissent plus comme une chimère au regard des capacités des batteries.

Les smartphones des superlatifs

Ajoutons à cela que Richard Yu a par ailleurs fait l'article d'un smartphone ultra-fin de la gamme P qui sera dévoilé au MWC (*Mobile World Congress*) en février prochain. Avec 6,45 mm d'épaisseur, la batterie devra également subir une cure d'amincissement même si le constructeur chinois pourrait jouer sur la taille du terminal (l'Ascend Mate dispose bien d'un écran de 6,1 pouces) pour maintenir sa capacité.

Capacité qui sera nécessaire puisqu'on imagine mal Huawei ne pas équiper ses futurs terminaux mobiles d'un modem **4G LTE**. En cela, il pourra compter sur une puce telle que le modem Balong 710 de Hisilicon.

2013 sera marqué par une surenchère quant au nombre de pixels affichés (1080p), à la taille des écrans (6,1 pouces pour le Ascend Mate) et au nombre de cœurs (8 pour les CPU du K3V3 de Hisilicon et [Exynos 5 Octa](#) de Samsung et 72 pour le GPU du Tegra 4).

Dans cette course que se livrent les constructeurs, Huawei ne s'en laisse pas compter. De surcroît, à plus long terme, le constructeur basé à Shenzhen disposera de processeurs 64 bits Cortex-A50 (Cortex-A53 et A57) puisque Hisilicon dispose des licences ARM idoines.